

橋本 典夫 氏



先端露光装置メーカーの(株)オーク製作所(東京都町田市小山ヶ丘3-9-5130)は、F C B G Aなど先端パッケージ基板用のダイレクト・イメージング(D I)装置やパワー半導体/アドバンスト・パッケージ用スッパーなど、高性能製品に特化した戦略を推進中だ。A Iチップや5 Gチップセットのほか、ミ

リ波用アンテナインパッケージ(A i P)向けなどの高性能パッケージ基板用途で旺盛な需要に応える。さらなる微細化や位置決め精度の向上が求められる次世代露光装置の開発も強化する。同社の橋本典夫会長に足元の市況ならびに今後の事業展開を聞いた。

——まず足元の事業環境から教えて下さい。

橋本 昨年以来、半導体の需要急拡大に伴い、チップを実装するパッケージ基板に対して旺盛な需要が継続している。特に、当社が注力している先端パッケージ基板に関

しては、韓国や台湾の顧客を中心に主力のD I装置に対して大量の受注残を抱えるほどリピートオーダーをいただいています。この需要は、19年度後半から顕在化してきた。一方で新型コロナの感染拡大の影響で、昨年のちょうどいつのところともに、引き合いが一気に増えた。こ

高性能D I、過去最大の受注

インタビュー

——今では不透明感が強くなった。リーマンショック以来の不況に見舞われるのでないかと身構えたが、これは杞憂に終わった。20年6月ごろから強い需要がより鮮明となり、受注・売上ともに順調に推移している。因は。

——D I装置の好調要

——ステッパー(P P

S)

については。

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——